C10 半孔测试针规格书

编号：BKZ-C10-002

版本：C10 半孔测试针规格书_V2.0

日期：2026 年 7 月 6 日

版本历史记录

版本	时间	描述
1.0	2023/07/04	初始版本
2.0	2026/07/06	D 款统一版本

目录

1、 概述.....4

2、 功能特点.....5

3、 应用场景.....6

4、 使用说明.....7

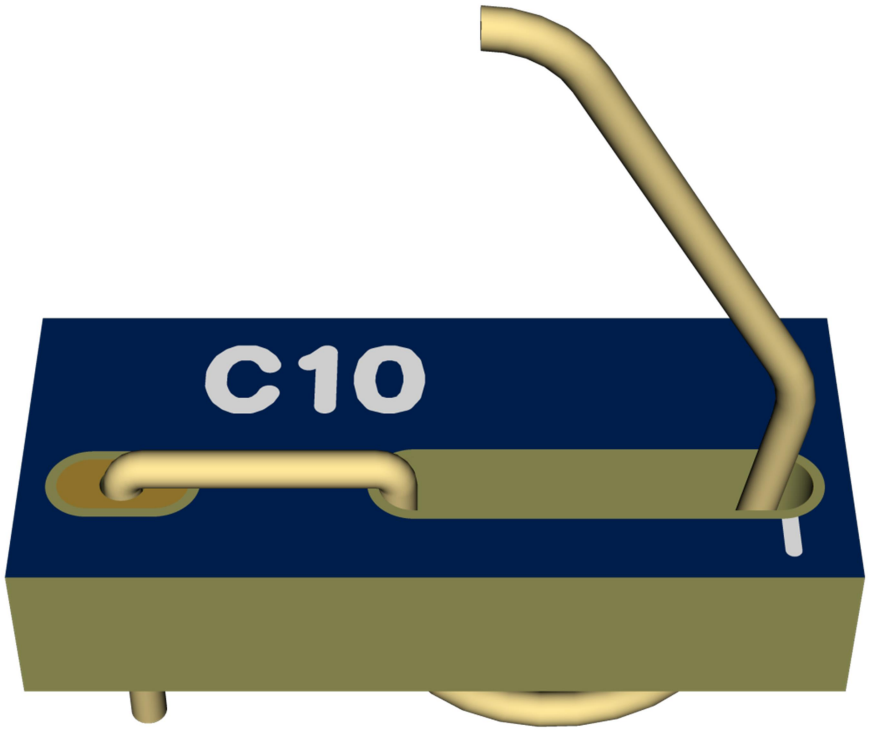
1、 概述

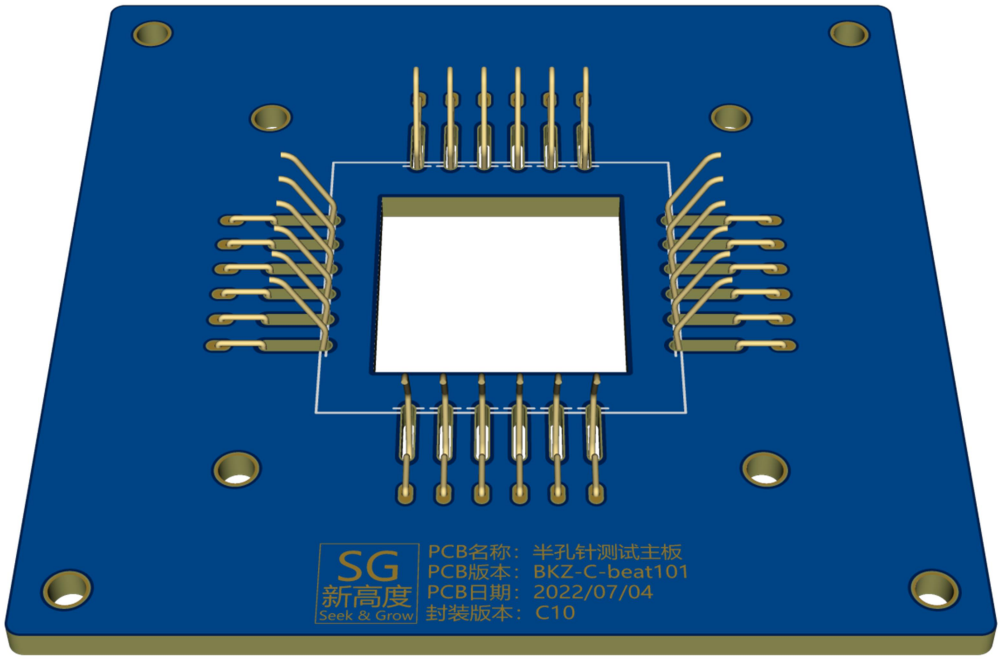
C10 半孔测试针可用于测试半孔或邮票孔形式封装的 PCB 板模块。

2、 功能特点

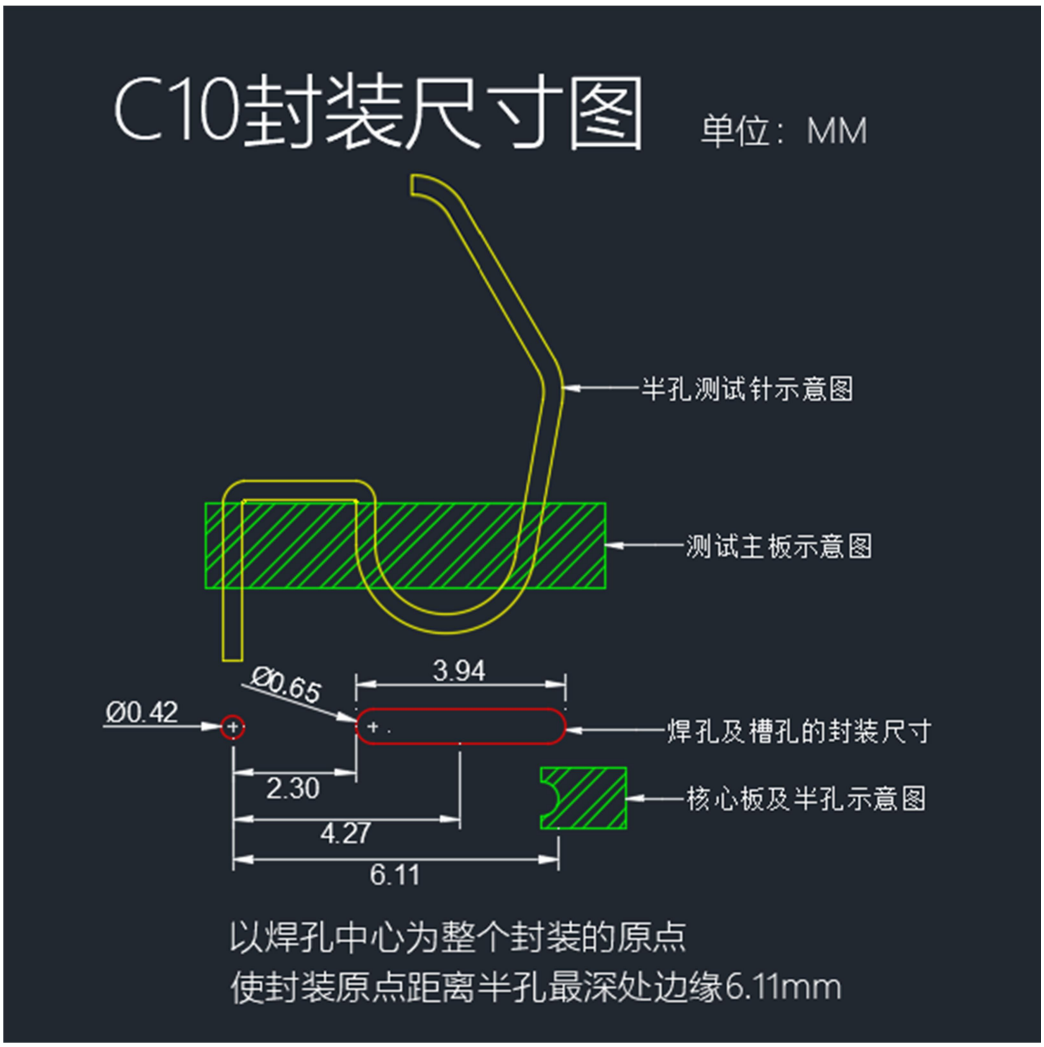
- 适用于：单边半孔模块、对边半孔模块、三边半孔模块、四边半孔模块；
- 材质：弹性钢；
- 线径：0.35mm；
- 表面处理：镀金；
- 自带定位结构：更利于安装及位置统一；

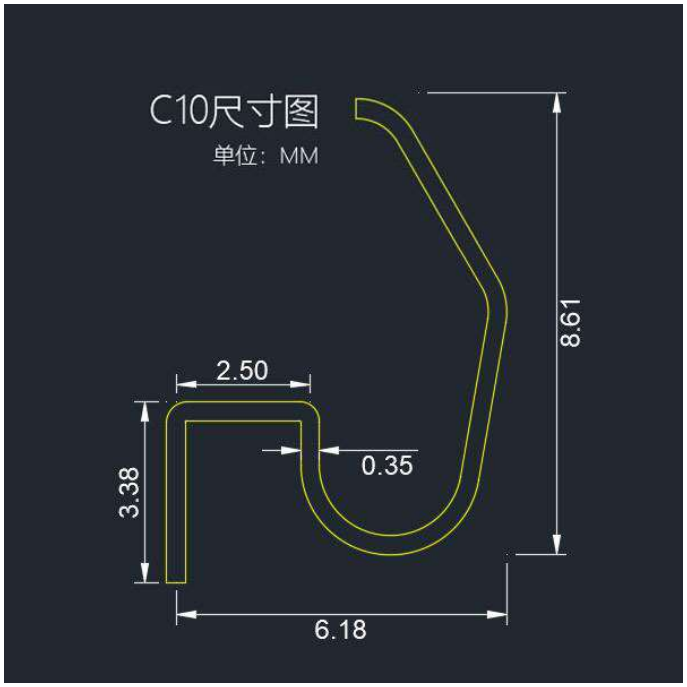
3、 应用场景




SG
新高度
Seek & Grow
PCB名称：半孔针测试主板
PCB版本：BKZ-C-beat101
PCB日期：2022/07/04
封装版本：C10

4、 使用说明


C10封装尺寸图
单位：MM
半孔测试针示意图
测试主板示意图
Ø0.65
3.94
Ø0.42
焊孔及槽孔的封装尺寸
2.30
核心板及半孔示意图
4.27
6.11
以焊孔中心为整个封装的原点
使封装原点距离半孔最深处边缘6.11mm


C10尺寸图
单位：MM
8.61
2.50
0.35
3.38
6.18